

平成 28 年 6 月 27 日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 7 番 17 号

株式会社テラプローブ

代表取締役社長 渡辺 雄一郎

「第 11 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成 28 年 6 月 13 日付で株主の皆様あてに送付いたしました、当社「第 11 期定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類「第 1 号議案 定款一部変更の件」について、議案の一部に修正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

【修正箇所】

第 1 号議案 定款一部変更の件（株主総会招集ご通知 55 ページ）

(2) 変更の内容

(修正前)

現 行 定 款	変 更 案
第 2 条 (目的) 本公司は、次の各号の事業を営むことを目的とする。 (1) 半導体集積回路の製造、検査、測定及び加工業務 (2) 前号に関連するハードウェア及びソフトウェアの開発、設計、製造、販売及び保守 (新 設)  (3) 労働者派遣事業 (4) 保有設備、治工具等のレンタルに関する事業 (5) 前各号に付帯または関連する一切の事業	第 2 条 (目的) 本公司は、次の各号の事業を営むことを目的とする。 (1) (現行どおり) (2) (現行どおり) (3) <u>情報処理・情報通信に関するサービス、ハードウェア及びソフトウェアの開発、販売、賃貸及び保守ならびにシステムの企画、開発、販売、運用及び保守</u> (4) (現行どおり) (5) (現行どおり) (6) (現行どおり)

(修正後)

現 行 定 款	変 更 案
第 2 条 (目的) 本公司は、次の各号の事業を営むことを目的とする。 (1) 半導体集積回路の製造、検査、測定および加工業務 (2) 前号に関連するハードウェアおよびソフトウェアの開発、設計、製造、販売および保守	第 2 条 (目的) 本公司は、次の各号の事業を営むことを目的とする。 (1) (現行どおり) (2) (現行どおり)

(新 設)	<u>(3) 情報処理・情報通信に関するサービス、ハードウェアおよびソフトウェアの開発、販売、賃貸および保守ならびにシステムの企画、開発、販売、運用および保守</u> <u>(4)</u> (現行どおり) <u>(5)</u> (現行どおり) <u>(6)</u> (現行どおり)
<u>(3) 労働者派遣事業</u> <u>(4) 保有設備、治工具等のレンタルに関する事業</u> <u>(5) 前各号に付帯または関連する一切の事業</u>	

以上

注：上記のグレー・ハイライト部分は修正箇所を分かりやすく示すためのものであり、現行定款に記載された、または、変更後の定款に記載されるものではありません。